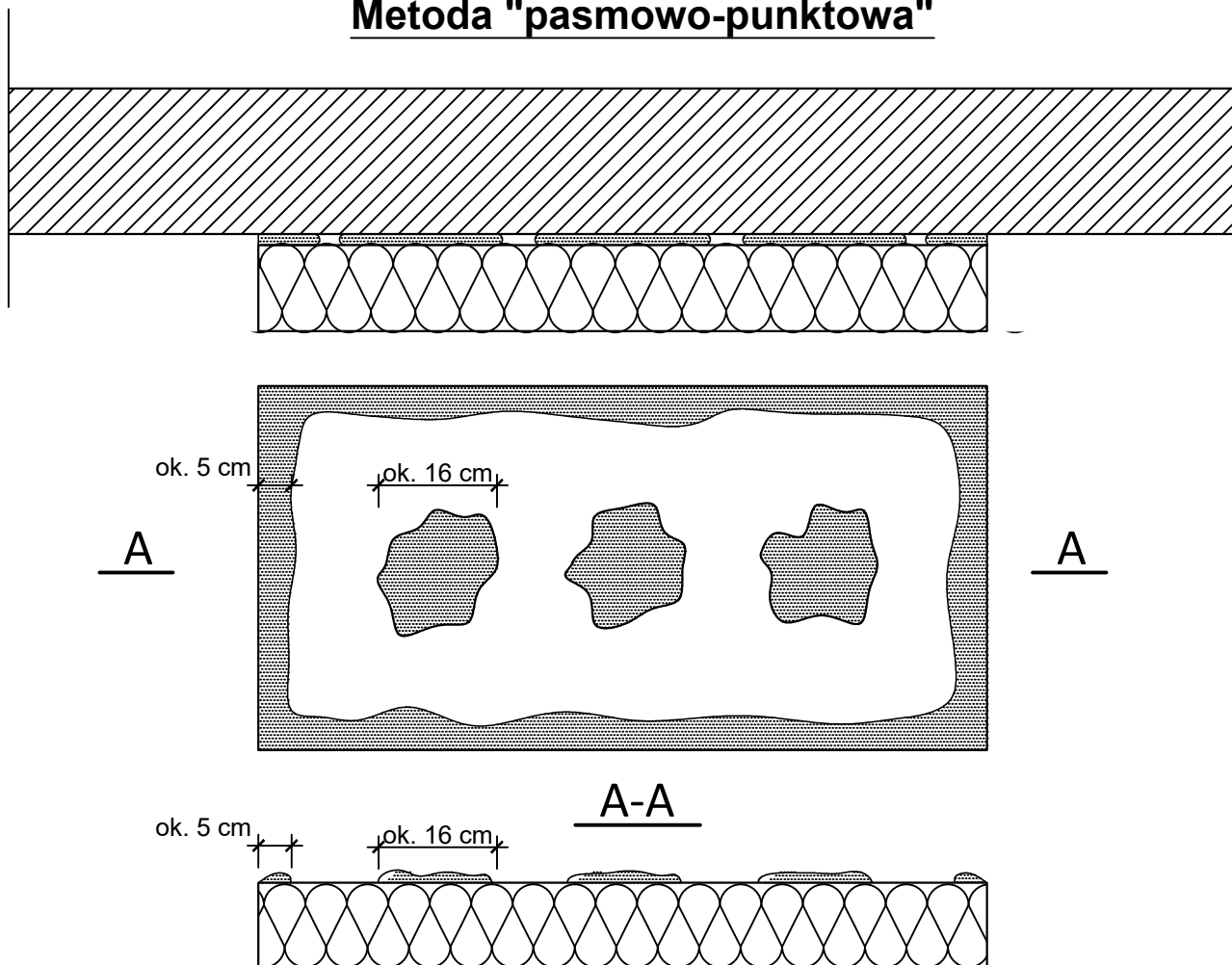


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

STYROPIAN

Metoda "pasmowo-punktowa"



Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się:

- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych,
- zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Użyte produkty należy każdorazowo przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!



Biurowisko projektowe EKOPROBUD
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. bp. Adama Śmigilewskiego 5
42-500 Będzin

**REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BP. ADAMA ŚMIGILEWSKIEGO 5 W BĘDZINIE**

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS:

09-2025

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SŁOKK

PODPIS:

SKALA:
1:10

OPRACOWANIE:

mgr inż. K. Krajewska

PODPIS:

NR RYS.:

KIEROWNIK BIURA:

dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

12